

江苏澳洋顺昌股份有限公司

关于签署投资意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、交易基本情况

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏省淮安市人民政府于2015年12月31日签署了《澳洋顺昌集成电路芯片项目投资意向书》（以下简称“投资意向书”）。

公司拟在淮安市清河新区投资建设一条8英寸集成电路芯片生产线，主要研发制造以硅基材料生产IGBT和Superjunction等，同时研发量产碳化硅材料的宽禁带半导体器件，预计投资总额为约15亿元人民币，将在未来1-2年内逐步完成。

2、交易批准程序

本投资意向书仅为双方合作意向，以便双方进一步磋商投资事项，公司后续将进行项目筹划与详细的可行性分析，具体投资事项需经董事会和股东大会审议通过后才能正式生效。

本投资意向书不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主体

甲方：淮安市人民政府

乙方：江苏澳洋顺昌股份有限公司

公司与协议对方无关联关系。

三、协议的主要内容

1、项目名称：

“8英寸集成电路芯片生产线”项目。

2、项目内容

本项目拟投资建设一条 8 英寸集成电路芯片生产线，主要研发制造以硅基材料生产 IGBT 和 Superjunction 等，同时研发量产碳化硅材料的宽禁带半导体器件。预计投资总额为约 15 亿元人民币，将在未来 1-2 年内逐步完成。项目完成后预计可实现年销售额超过 20 亿元（上述数据仅为初步预计）。

3、双方权利、义务

甲方承诺配合乙方完成项目筹划所需的相关事项，在乙方正式投资后，甲方成立“8 英寸集成电路芯片生产线”项目领导小组，在乙方备齐相关资料的基础上，协助乙方办理“8 英寸集成电路芯片生产线”项目的立项、环保、消防、土地、规划等各项审批手续，保证项目建设所需的水电等基础设施配套，积极协调处理项目建设中遇到的问题，配合乙方尽快开工建设并投产。

同时，鉴于乙方投资项目为当前国家积极鼓励和大力发展的战略性新兴产业，甲方同意根据实际情况为乙方提供“8 英寸集成电路芯片生产线”项目专项扶持资金，用于该项目建设，并帮助、支持乙方向国家、省市申请争取各项扶持资金和扶持政策。

乙方在清河新区新上“8 英寸集成电路芯片生产线”项目，研发制造以硅基材料生产的半导体器件和碳化硅材料的宽禁带半导体器件。

乙方集成电路芯片生产线项目投资总额人民币 15 亿元，2016 年开工建设。

乙方实际投资事项须经其董事会及股东大会审批后生效。。

四、投资目的及对上市公司的影响

目前我国已成为全球主要的半导体芯片使用国家，同时国外半导体产业有向我国转移的趋势，但我国半导体企业的技术积累和规模效应较国际大厂仍有较大差距。国内功率半导体企业目前主要以生产低端的功率器件或从事代工业务，国外以硅基材料生产 IGBT 和 Superjunction 以及宽禁带半导体芯片等自主核心技术国内企业几乎是空白。近年来，中国已成为 IGBT、Superjunction 和宽禁带半导体芯片等最大消费国，而且每年以 30% 以上的速度增长。例如 IGBT 市场主要被欧美、日本企业所垄断，广泛应用的大功率 IGBT 器件基本上依赖进口，在交货周期和采购价格上完全受制于国外公司。境外大型半导体公司凭借其雄厚的资金实力和技术积累占据了较大的市场份额，并在某些高端半导体设计和制造方面持

续处于垄断地位。

从集成电路产业链结构看，半导体材料制造业、IC 设计业、封装和测试业分别占全球半导体产业整体营业收入的 50%、27%、和 23%。而国内集成电路行业则相反，封测占比较大，近年随着相关政策的出台，设计环节发展较快，而材料制造始终处于薄弱环节。同时近期作为与“德国工业 4.0”的对标，国家制造强国建设战略委员会编制了《中国制造 2025》，明确了建设制造强国的战略任务和重点。《中国制造 2025》是我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领，而碳化硅宽禁带功率半导体器件已在《中国制造 2025》的发展重点中。

鉴于半导体功率电子器件行业是国家重点扶持的新兴产业、高新技术产业，广泛运用于工业领域和新兴产业，具有较好的市场前景。该项目如能顺利实施，并迅速形成产能、将填补国家该行业部分领域的空白，同时就能获得产业发展的先发优势，在全国率先形成生产，打造产业链，成为该产业领域的先发地区、核心板块。

公司多次在发展战略里强调在 LED 相关领域（如紫外线、功率元器件等方向）进行发掘，通过建设、并购等可能的手段，做大做强 LED 及半导体相关业务，实现产业链的有效延伸。公司本次签署投资意向书，拟投资建设一条 8 英寸集成电路芯片生产线，符合既定发展战略，有利于把握行业发展的机遇，形成新的发展着力点，极大提升公司行业地位与竞争力。

五、风险提示

1、本投资意向书仅为合作意向，具有一定的不确定性。后续公司将详细筹划相关具体投资方案，具体投资事项需提交公司董事会及股东大会审议批准后方可生效。

2、本投资意向书提及的投资规模及相关销售等数据仅为初步预计，投资方案及最终实际投产情况都面临工程建设、市场情况等各种因素，具有不确定性。

3、虽然公司目前已经在半导体业务领域积累了较为丰富的技术和管理经验，培养了一大批技术和管理骨干，但研发制造以硅基材料生产的半导体器件和碳化硅材料的宽禁带半导体器件仍需要极强的技术及管理实力，本项目在技术及管理上存在一定的风险。

4、该项目实际建设及投产需要一定的时间，市场存在变化的可能，从而影

响到项目的预期收入等。

公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、《澳洋顺昌集成电路芯片项目投资意向书》。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日